

限制輸出貨品表
貨品輸出規定變更明細表

貨品號列	貨名	原列 輸出規定	改列 輸出規定
7102.10.00.00-1	金鋼石（鑽石）未分選者	121 486	121* 486
7102.21.00.00-8	工業用金鋼石（鑽石），未加工或僅鋸、劈或磨邊者	121 486	121* 486
7102.31.00.00-6	非工業用金鋼石（鑽石），未加工或僅經鋸、劈或磨邊者	121 486	121* 486
8486.10.00.20-1	供半導體晶圓製程用之磨光、拋光及研磨機器	121 488 S01 S03	121* 488* S01 S03
8486.20.00.11-0	生產半導體用化學氣相沈積器具	121 488 S01 S03	121* 488* S01 S03
8486.20.00.12-9	製造半導體用之物理氣相沈積器具	121 488	121* 488*
8486.20.00.31-6	供半導體材料乾式蝕刻圖形用工具機	121 488 S01 S03	121* 488* S01 S03
8486.20.00.32-5	供蝕刻、去除光阻物或清洗半導體晶圓之噴灑機具	121 488 S01 S03	121* 488* S01 S03
8486.20.00.33-4	供濕蝕刻、顯影、去除光阻物或清洗半導體晶圓之器具	121 488 S01 S03	121* 488* S01 S03
8486.20.00.40-5	半導體晶圓磊晶沈積機	121 488	121* 488*
8486.20.00.50-2	供摻雜半導體材料之離子植入器	121 488 541 S01 S03	121* 488* 541 S01 S03
8486.20.00.61-9	生產半導體晶圓用之步進及重複對準機	121 488 S01 S03	121* 488* S01 S03
8486.20.00.62-8	生產半導體晶圓用之掃描對準機	121 488 S01 S03	121* 488* S01 S03
8486.20.00.63-7	電子束直接寫入晶圓器具	121 488 S01 S03	121* 488* S01 S03
8486.20.00.71-7	半導體晶圓加工用旋轉乾燥機	121 488	121* 488*
8486.20.00.72-6	供感光乳劑塗附在半導體晶圓上之旋轉器	121 488	121* 488*
8486.20.00.73-5	製造半導體晶圓用之光阻塗佈器具	121	121*

		488	488*
8486.20.00.80-6	供半導體晶圓氧化、擴散或回火用之快速加熱器具	121 488 S01 S03	121* 488* S01 S03
9031.41.10.10-2	附有專供半導體晶圓或網線上下料及傳送設備用之顯微照相顯微鏡	121 488	121* 488*
9031.80.00.20-4	附有專供半導體晶圓或網線上下料及傳送設備用之電子束顯微鏡	121 488 S01 S03	121* 488* S01 S03

號列項數：20

輸出規定代號說明

121	由貿易局簽發輸出許可證。
121*	由經濟部國際貿易署簽發輸出許可證。
486	應檢附我國政府指定機關核發之 Kimberley Process 證書。
488	一、輸出化學機械研磨機、光阻剝除機、光阻顯影機、快速高溫熱處理機、沉積設備、洗淨設備、乾燥機、電子顯微鏡、蝕刻機、離子植入機、光阻塗佈機、微影設備等十二類半導體晶圓製造設備，應檢附下列文件申請輸出許可證，出口人並應於輸出許可證列明所生產之晶圓尺寸及製程技術水準；違者，應自負相關法律責任：（一）輸往大陸地區者，如屬投資行為者，應檢附經濟部投資審議委員會核准投資文件；如非投資行為者，應檢附非投資行為之切結書。輸往大陸以外地區者，應檢附保證不以輸出許可證上所載貨品投資大陸地區之切結書。（二）輸出 CCC8486.20.00.40-5「半導體晶圓磊晶沉積機」、CCC8486.20.00.50-2「供摻雜半導體材料之離子植入器」、CCC8486.20.00.61-9「生產半導體晶圓用之步進及重複對準機」、CCC8486.20.00.62-8「生產半導體晶圓用之掃描對準機」及 CCC8486.20.00.63-7「電子束直接寫入晶圓器具」等 5 個貨品分類號列項下之貨品，應另檢附經濟部出具之非屬戰略性高科技貨品鑑定報告或該設備供應商之出口管制確認非屬戰略性高科技貨品文件。（三）屬戰略性高科技貨品列管項目者，除應檢附上述（一）文件外，應另依戰略性高科技貨品輸出入管理辦法相關規定辦理。二、輸出非屬上述十二類半導體晶圓製造設備者，應檢附經濟部出具之非屬十二類半導體晶圓製造設備及非屬戰略性高科技貨品鑑定報告，申請輸出許可證。三、保稅區或課稅區或自由貿易港區間之半導體晶圓製造設備移轉，免辦理輸出許可證。
488*	一、輸出化學機械研磨機、光阻剝除機、光阻顯影機、快速高溫熱處理機、沉積設備、洗淨設備、乾燥機、電子顯微鏡、蝕刻機、離子植入機、光阻塗佈機、微影設備等十二類半導體晶圓製造設備，應檢附下列文件申請輸出許可證，出口人並應於輸出許可證列明所生產之晶圓尺寸及製程技術水準；違者，應自負相關法律責任：（一）輸往大陸地區者，如屬投資行為者，應檢附經濟部核准投資文件；如非投資行為者，應檢附非投資行為之切結書。輸往大陸以外地區者，應檢附保證不以輸出許可證上所載貨品投資大陸地區之切結書。（二）輸出 CCC8486.20.00.40-5「半導體晶圓磊晶沉積機」、CCC8486.20.00.50-2「供摻雜半導體材料之離子植入器」、CCC8486.20.00.61-9「生產半導體晶圓用之步進及重複對準機」、CCC8486.20.00.62-8「生產半導體晶圓用之掃描對準機」及 CCC8486.20.00.63-7「電子束直接寫入晶圓器具」等 5 個貨品分類號列項下之貨品，應另檢附經濟部出具之非屬戰略性高科技貨品鑑定報告或該設備供應商之出口管制確認非屬戰略性高科技貨品文件。（三）屬戰略性高科技貨品列管項目者，除應檢附上述（一）文件外，應另依戰略性高科技貨品輸出入管理辦法相關規定辦理。二、輸出非屬上述十二類半導體晶圓製造設備者，應檢附經濟部出具之非屬十二類半導體晶圓製造設備及非屬戰略性高科技貨品鑑定報告，申請輸出許可證。三、保稅區或課稅區或自由貿易港區間之半導體晶圓製造設備移轉，免辦理輸出許可證。
541	應檢附核能安全委員會同意文件。
S01	輸往北韓敏感貨品清單內列管項目出口或再出口至北韓者，應向經濟部國際貿易署或經濟部委任或委託之機關（構）申請戰略性高科技貨品輸出許可證，並憑以報關出口。
S03	輸往伊朗敏感貨品清單內列管項目出口或再出口至伊朗者，應向經濟部國際貿易署或經濟部委任或委託之機關（構）申請戰略性高科技貨品輸出許可證，並憑以報關出口。